管理計画 (SOT-23D)
CONTROL PLAN (SOT-23D)

代表例

ﾄﾚｯｸｽ・ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ株式会社
TOREX SEMICONDUCTOR LTD.

工程記号 Flow	No.	工程名 Process	主な管理項目 Major item checked	頻度 Frequency	ﾌﾟﾛｾｽ Process
◇	1	ｳｴﾊ受入 Wafer incoming	ﾛｯﾄ番号, 員数照合 Lot No., Q'ty check	抜き取り Sampling	ｳｴﾊ工程(外注) Wafer process
○	2	酸化 Oxide	時間, 温度 Temperature, Time	ﾁｭｰﾌﾞ交換時 Tube change	
◇	3	酸化膜ﾁｪｯｸ Oxide check	外観, 酸化膜厚 Appearance・OX thickness	抜き取り Sampling	
◇	4	ﾁｪｯｸ Check	外観, 測定 Appearance・Measure	抜き取り Sampling	
○	5	ﾌｫﾄ工程 Photo lithography	品番照合 Against photo mask	作業開始時 At Starting	
◇	6	ﾁｪｯｸ Check	外観, 欠陥密度 Appearance・Defect density	抜き取り Sampling	
○	7	拡散 Drive	温度, 時間 Temperature, Time	作業開始時 At Starting	
◇	8	ﾁｪｯｸ Check	ｼｰﾄ抵抗, 酸化 Sheet resistance, Oxidation	抜き取り Sampling	
○	9	金属膜形成 Metal deposition	真空度 Vacuumness	作業開始時 At Starting	
◇	10	ﾒﾀﾙﾁｪｯｸ Metal check	外観, 厚み, 表面状態 Appearance , Thickness, Surface	抜き取り Sampling	
◇	11	ｳｴﾊﾁｪｯｸ Wafer check	測定 Process Control Monitor	抜き取り Sampling	
◇	12	ｳｴﾊﾃｽﾄ Wafer test	電気的特性 Electrical characteristics	100%	組立工程(外注) Assembly process
○	13	ﾀﾞｲｼﾝｸﾞ Dicing	位置ずれ, ﾌﾞﾚｰﾄﾞの磨耗 Position, Blade Condition	作業開始時 At Starting	
○	14	ﾀﾞｲﾎﾞﾝﾄﾞ Die attach	位置, 塗布量 Position, Amount of Coating	抜き取り Sampling	
○	15	ﾜｲﾔﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ Wire bonding	外観, 位置, ﾙｰﾌﾟ, 引張強度 ﾎﾞｰﾙｼｪｱ, ﾀﾞｲｼｪｱ Appearance, Position, Loop shape, Wire pull strength, Ball share strength, Die share strength	抜き取り Sampling	
○	16	ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ Molding	外観, X線検査 Appearance, X-ray check	抜き取り Sampling	
○	17	ﾏｰｷﾝｸﾞ Marking	外観 Appearance	抜き取り Sampling	
○	18	はんだﾒｯｷ Solder plating	ﾒｯｷ厚, 液組成 Plating thickness, composition	定期 Regularly check	
○	19	ﾘｰﾄﾞｶｯﾄ/ﾌｫｰﾐﾝｸﾞ Lead cut/Forming	寸法測定 Measuring dimensions	抜き取り Sampling	
◇	20	電気的特性検査 磁束特性検査 外観検査 ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ Electrical test Magnetic test Visual check Taping	電気的特性 磁束特性 ﾏｰｸ, ﾘｰﾄﾞ ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ強度 Electrical characteristics Magnetic characteristcs Mark, Lead Taping strength	100% 100% 100% 1回/日 100% 100% 100% Per day	
◇	21	出荷検査 Out going inspection	ﾗﾍﾞﾙ, 外観検査 Label, Appearance	抜き取り Sampling	
○	22	梱包出荷 Packing /Shipping	伝票照合 Verification of product against slip	1回/ロット Per lot	